

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部**成分表**製品名(鉛フリー): XC6190xxxx8R-G
標準質量: 1.3 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.154	シリコン	118300	7440-21-3
	-	砒素	<1	7440-38-2
リードパッド	0.177	ニッケル	135900	7440-02-0
	0.003	金	2500	7440-57-5
ダイアタッチ	0.022	エポキシ樹脂	16700	—
	0.013	アクリル樹脂	10000	—
ボンディングワイヤ	0.045	金	34900	7440-57-5
封止樹脂	0.587	溶融シリカ	451300	60676-86-0
	0.083	エポキシ樹脂	64100	—
	0.083	フェノール樹脂	64100	—
	0.114	金属水酸化物	87600	—
	0.019	結晶シリカ	14600	14808-60-7

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 重量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせて頂いております。